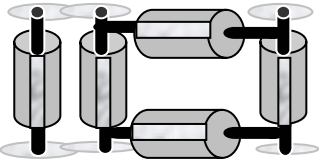
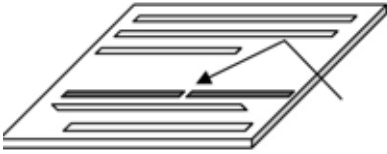
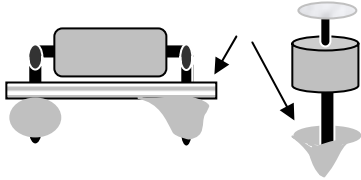
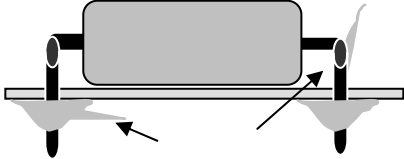

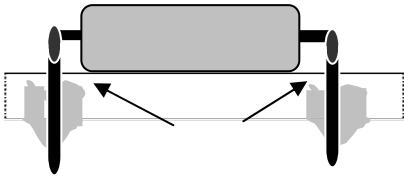
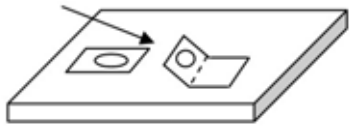
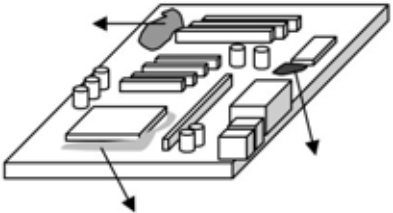
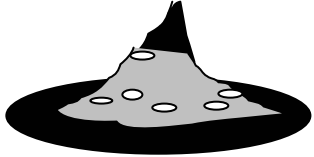
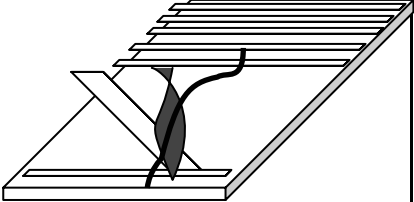
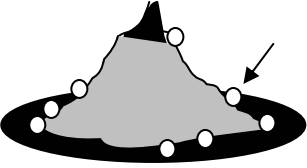
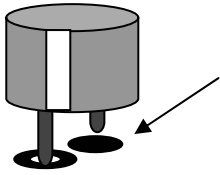
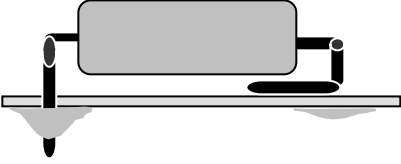
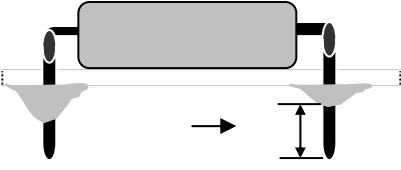
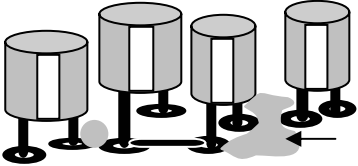
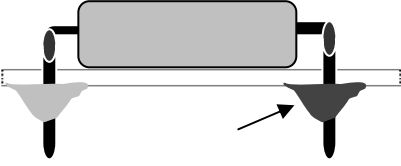
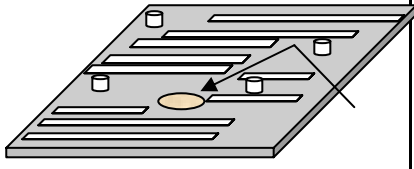
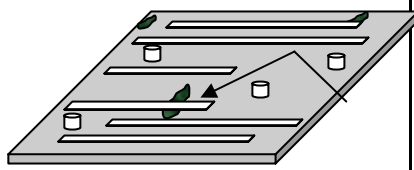
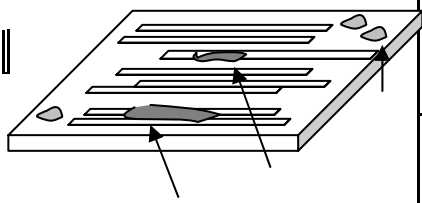
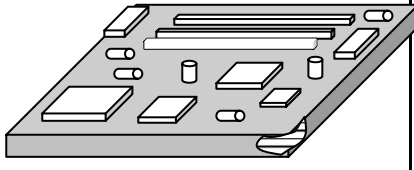
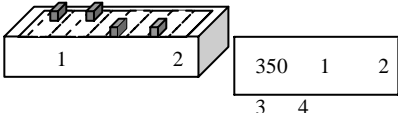
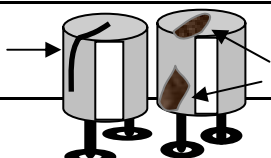


2.DIP 组装作业				
序号	现象	不良描述	示意图	判定
2.1	缺件	PCB 板位置应有零件而未插零件		MA
2.2	错件	不符合 BOM 的料号或厂牌. 位置错误		MA
2.3	多件	PCB 板位置不应有零件而有多余之零件		MA
2.4	反向	正负极性相反. 零件方向错误		MA
2.5	零件破损	(A) 伤及零件本体或破损影响电性功能		MA
		(B) 未伤及本体或破损不影响电性功能		MI
2.6	空焊	零件的 PIN 未沾附锡之现象		MA
2.7	(A) 立式零件浮高	(A) 立式零件(电解, 二极管, 单独跳线... 等)H>1mm 以上		MI

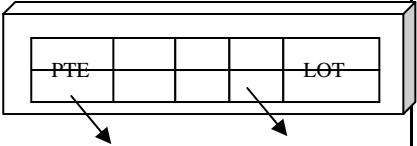
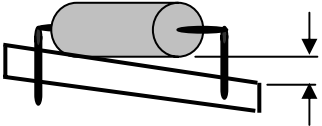
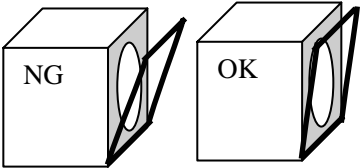
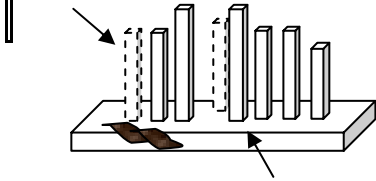
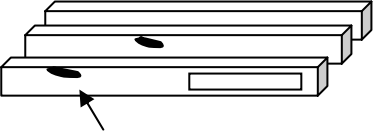
	(B) 卧式零件 浮高	(B) 卧式零件 (DIMM, SLOT, 散热片, K/B 座等) $H > 0.5\text{mm}$ 以上		MA
2.8	短路	不应导通而导通包含锡渣(球). 锡桥(丝)或残留之导体等形成的短路		MA
2.9	断路	因导通而未导通如 PCB 板线路断线之现象		MA
2.10	包焊	(A) DIP 零件锡量超过下弯或 PAD 范围(B) 看不见 DIP 零件脚轮廓		MI
2.11	锡尖	超过 1.0mm 以上不允许 (包含水平状与垂直状形成的锡尖)		MI
2.12	锡裂、露铜	零件焊锡面有裂痕或龟裂的现象或露铜从本体往外延伸 $> 1.0\text{mm}$		MI
2.13	锡不足	零件面锡凹陷, 如零件孔内无法目视见锡底面, 锡垫上未达 75% 孔内填锡。		MI

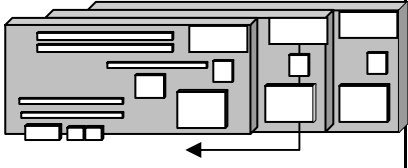
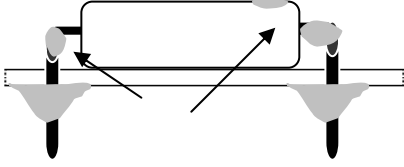
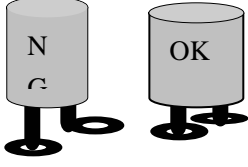
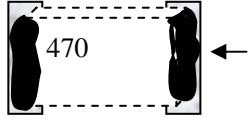
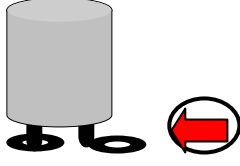

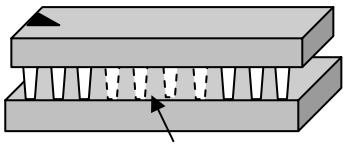
2.14	焊墊翹皮	作业不慎或其它因素造成 PCB 损伤导致线路. 焊墊(点)翹起(修补后可接受)		MA
2.15	不洁	(A) 零件或 PCB 不可有油污.水纹.松香...等		MI
		(B) PCB 板不可任何松香残留物面积大于 50mm		MA
		(C) 零件或 PCB 板不可有白粉之现象		MI
2.16	针孔	1.三倍以内放大镜一 目视可见之钊洞/针孔		MA
		2.钊洞/针孔不能贯穿过。		MI
2.17	刮伤	(A) 刮伤长度(所有刮痕相加)超过 7cm(未露铜)		MA
		(B) 刮伤长度(所有刮痕相加)低于 7cm(未露铜)		MI
		(C)刮伤伤及线路(露铜)		CR

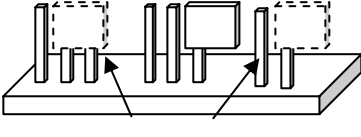


2.18	锡球 (渣)	(A)固定不脱落之锡球 直径大于 10mil (0.25mm) 或 chip 最小 pth1/2 (B)未固定可能掉落之锡球 直径大于 5mil(0.125mm)		MI
2.19	孔塞	因制程或其它因素造成 零件孔.螺丝孔等孔塞		MA
2.20	零件跪脚 (折脚)	零件的 PIN 未插入零件孔位 (脚座) 而造成折脚之现象		MA
2.21	零件脚长	零件脚长(H) > 2.5mm 不允许 , 最短不定尺寸 但零件脚必需外露可见		MA
2.22	残留异物	(A)板上残留可能会危害电气功能之异物如铁脚.锡渣...等		MA
		(B)板上残留异物不会危害电气功能如棉絮...等		MI
2.23	焊点氧化 (腐蚀)	零件的 PIN, 本体有生锈或氧化的现象 (生锈现象如呈咖啡, 深土黄色. 氧化现象如呈暗灰)		MA

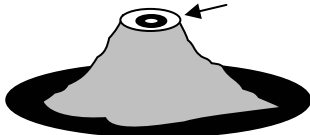
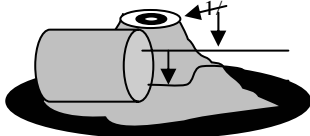
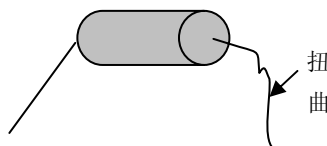
		色,露铜青绿色)		
2.24	PCB 层间剥离	(A)直径大于 3mm 之圆状剥离(起泡) (B)起泡处超过 2 处 (C)起泡位于 CPU 及 BGA 处		MA
2.25	PCB 防焊漆不良	PCB 经烘烤后造成防焊漆变色或破裂脱落...等现象其面积不得超过 2*2mm		MI
2.26	PCB 沾锡	(A)沾锡区域超过 5mm*2mm		MA
		(B)沾锡呈尖镜状或脱落造成短路之虑		MI
		(C)沾锡区域超过 3 处		MI
2.27	PCB 摔板 (剥层)	因制程中不慎造成 PCB 摔落使得内层剥落(修补后可接受面积不超过 5*5mm)		MA
2.28	设定错误	JUMPER, DIP SWITCH 未依 BOM(ECN) 设定或缺落 (脱落)		MA
2.29	零件刮伤	(A)零件刮伤露底材不		MA

		允许		
		(B) 刮伤不露底材 (PCB 经修补后可以接受)		MI
2.30	点胶不良	(A) 零件未点胶或点胶不良造成零件弹起, 脱落... 等现象		MI
		(B) 点胶范围 $H > 3\text{mm}$ 不接受		MI
		(C) 热熔胶沾附周围零件造成不洁之现象不接受		MI
2.31	螺丝松动(生锈)	(A) 螺丝缺件, 生锈... 等造成零件脱落, 咬死之现象		MI
		(B) 因螺丝滑牙而无法将螺丝旋起或损伤螺丝本体		MI
		(C) 螺丝未锁紧造成零件松动之现象		MI
2.32	印刷不良	零件油墨印刷, 雷射镭刻和卷标贴纸无法清楚辨识规格		MI
2.33	贴纸不良	(A) 品名, 序号, BIOS 等贴纸漏贴, 贴错... 等现象		MA

		(B) 贴纸贴歪, 不洁, 模糊...等现象		MI
2.34	标签不良	标签贴错, 测试章, ICT 章...等模糊不易辨试、未盖章、破损无法辨识。		MI
2.35	零件歪斜	零件歪斜 高低差 >0.5mm 或超过 15 度 (前后左右) 不接受		MI
2.36	弹片变形	弹片弯曲(扭曲)或未平贴...等现象都不允许		MI
2.37	排针变形	(A) 排针本体严重变形 治具无法插入或抽 PIN 装反... 等		MA
		(B) 本体底座刮伤, 破损... 不露底材		MI
		(C) 排针弯曲变形 (指可修复者) 而不影响治具的插入		MI
2.38	零件热溶	零件修补或制程处理不慎等因素造成外观遇热有溶化之现象		MA

2.39	混板 (料)	机种,工令,料件未依客户通知或制令...等规定区分清楚而混在一起		MA
2.40	零件沾锡	零件修补,制程不慎...等因素造成零件面沾附锡之现象		MI
2.41	未入定位(插错孔位)	零件未完全放(插)置于正确位置或孔位		MA
2.42	零件撞落	拿板,放板,搬运...等过程中碰'撞使零件掉落造成掉件之现象		MA
2.43	不明标签	修改(补)前所贴的标示于修改(补)完成后未撕掉		MI
2.44	SOCKET 反向	后插零件的脚座与 PCB 板标示方向相反 (SOCKET 有插零件和无插零件反向都不接受)		MA
2.45	零件断 PIN	(A)零件断 PIN 会影响电气功能如 CHIPS, IC...等		MA
		零件断 PIN 不影响电气或组件不良所致如		MI

		SLOT , SIMM . . . 等		
2.46	JUMPER 设定错误	(A) JUMPER 设错, 漏插, 脱落 . . . 等影响电气功能		MA
		(B) JUMPER 插单 PIN 脱落不影响电气功能		MI
		bad dissipate heat slice		MI
2.47	散热片不良	(A) 散热片严重刮伤, 断裂 . . . 等或装反成和周围零件接触到		MA
		(B) 散热片未锁紧松动, 歪斜 1mm, 胶带未贴 . . . 等		MI
2.48	CONN 不良	(A) CONN 严重刮伤, 破裂. 变形 . . . 等或和周围零件接触到影响功能		MA
		(B) CONN 松动, 歪斜, 胶带未贴. 弹片变形. 轻微刮伤 (可修复) . . . 等不影响功能		MI
2.49	排针变形	排针变形, 高低差超过 0.5mm		MI

2.50	锡洞	零件剪脚后产生的小孔, 不影响电气/外观功能性		MI
2.51	零件脚变型	震荡器零件脚脚距少于原始脚距 1/3		MI
2.52	零件脚扭曲或露铜	零件脚扭曲或露铜从本体往外延伸 > 1.0mm		MI
2.53	折让板定标准(有以下缺点则判定拒收, 须折让至供货商)			
2.53-1	修补处一面超 3 点, 一片超过 5 点。			
2.53-2	修补处小于第一项规定, 但长度大于 30mm 或面积大于 10mm ² 及直径大于 7mm 之圆。			
2.53-3	补线长度超过 10mm			
2.53-4	PAD 连接处 2mm 内或离转角处 2mm, 不可修补。			
2.53-5	相邻线路不可同时补线。			
2.53-6	任何凡需移动板面零件才可维修之板子, 将不予以维修机会。			